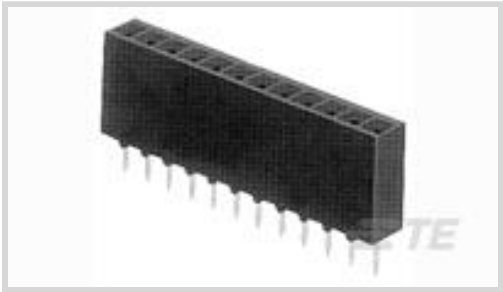




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: **3**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装母端 |
| 连接器系统     | 板对板      |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 板对板配置    | 平行 |
| 可堆叠      | 否  |
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 位数       | 3  |
| 行数       | 1  |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 连接器外形  | 标准 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |

接触件特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 端子底板材料   | 镍               |
| 接合插针直径   | .64 mm[.025 in] |
| 端子底板材料厚度 | 1.27 μm[50 μin] |



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 端子接合区域电镀材料厚度     | .762 μm[30 μin]               |
| 接合方柱尺寸           | .64 mm[.025 in]               |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 3 – 5 μm[118.11 – 196.85 μin] |
| 端子布局             | 直插式                           |
| 端子保护类型           | 闭合入口壳体                        |
| 端子基材             | 磷青铜                           |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 锡                             |
| 端子接触部电镀材料        | 钯镍打底镀金                        |
| 端子类型             | 插座                            |
| 端子额定电流（最大值）      | 3 A                           |

端接特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .7 mm[.027 in]  |
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .2 mm[.008 in]  |
| 端接柱体和尾部长度的  | 3.05 mm[.12 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接         |

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| PCB 安装固定 | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 不带  |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 接合入口位置  | 底部和顶部          |
| 外壳材料    | 聚酯 GF          |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 堆叠高度       | 2.29 mm[.09 in] |
| PCB 厚度（建议） | 1.6 mm[.063 in] |
| 连接器高度      | 6.2 mm[.244 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|



行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | Carton |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



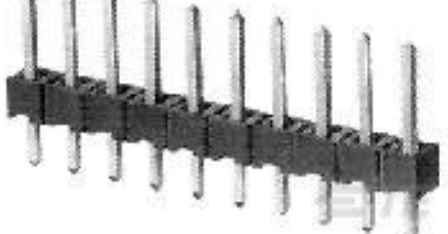
TE 产品编号 826652-3  
3P AMPMODU II STIFT LEI



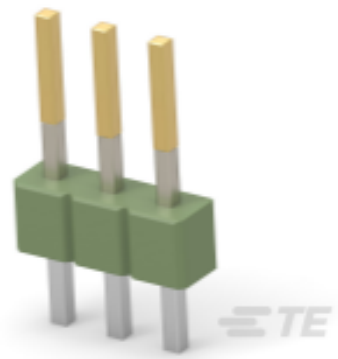
TE 产品编号 826654-3  
3P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 826631-3  
3P AMPMODU II STIFT LEI



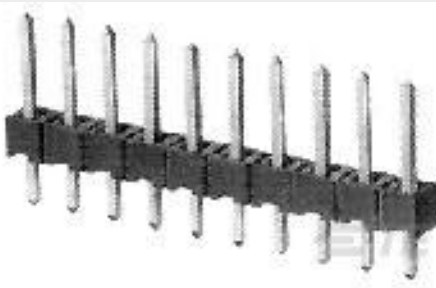
TE 产品编号 826648-3  
3P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 826629-3  
3P AMPMODU II



TE 产品编号 966306-3  
MOD2 ST-LEI SMD 3P



TE 产品编号 826630-3  
3P AMPMODU II STIFT LEI



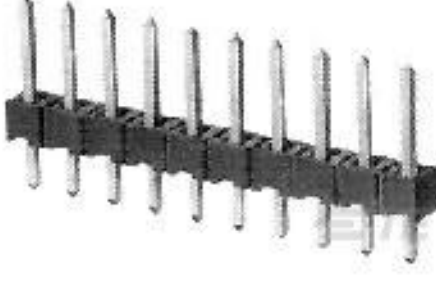
TE 产品编号 1241150-3  
3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER



TE 产品编号 826647-3  
3P AMPMODU II STIFT LEI

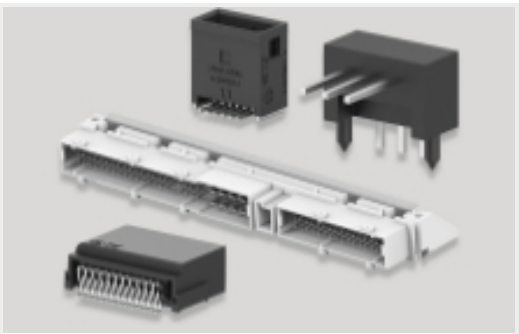


TE 产品编号 966710-3  
MODU II PIN HEADER, SGL ROW, SMD- 3 POS

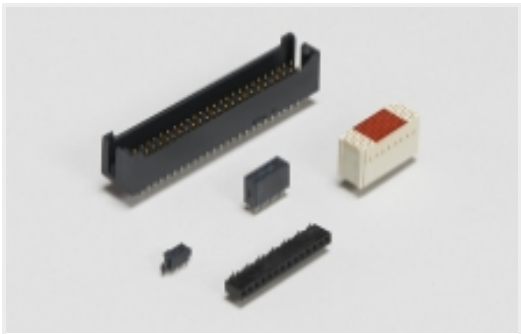


TE 产品编号 826646-3  
3P AMPMODU II STIFT LEI

该系列中的其他产品 | [AMPMODU HV-100/HV-190](#)



PCB 板端连接器及母端(321)

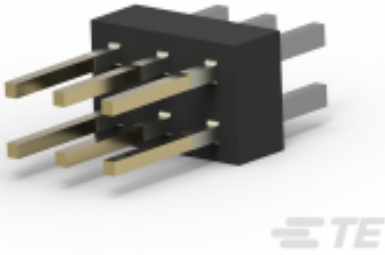


板对板接头和插座(321)

客户还购买了



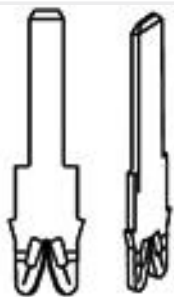
TE 产品编号150699-2  
187 FASTON, FLAG, REC., 20-16 AWG, TPBR



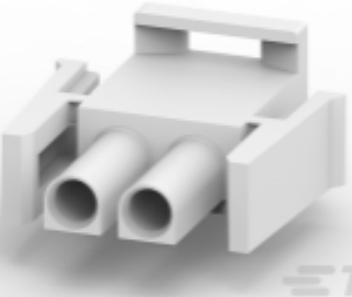
TE 产品编号215447-3  
2X 3P MOD2 STIFTLEI



TE 产品编号925075-7  
4W CIRCULAR MATE-N-LOK PIN HSG NAT



TE 产品编号4-1601090-2  
031-161-002= TAB, 2.0X.51, STD SMZ



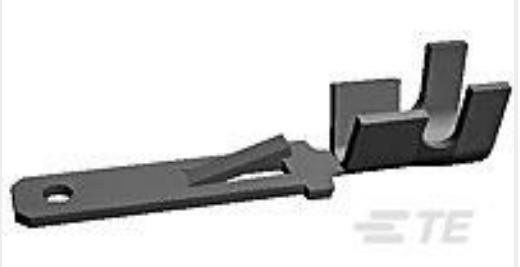
TE 产品编号1-1703061-3  
PLUG, 2 CIRCUIT, UNIVERSAL MATE-N-LOK



TE 产品编号1903747-1  
MINI UMNL GWT 2P PLUG HSG



TE 产品编号EQ08993001  
FLDWC0311-24-9CK1500



TE 产品编号170058-2  
FF 110 TAB 24-20AWG TPBR



TE 产品编号6-1601090-2  
[031-161-002=TAB,2.0X.51,STD5MZ](#)

TE 产品编号1-1718627-1  
[AMP MCP 2.8 HSG. 3POS.,ASS'Y](#)

文档

产品图纸

[3P HV100 REC.CON. B/TE,6.2,NO KINK](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_829265-3\\_F.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_829265-3\\_F.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_829265-3\\_F.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。